

PAD AREA

KEEP OUT AREA

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ± 0.05

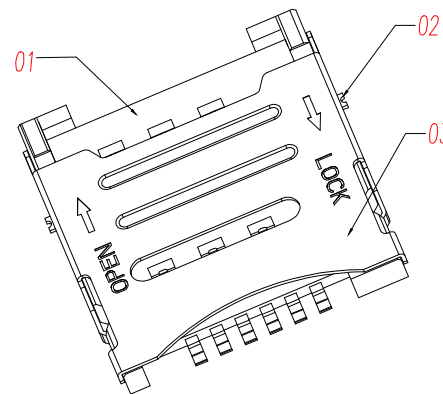
一、材质和镀涂:

1. 胶芯: LCP, UL 94V-0, 黑色
2. 端子: 磷铜 C5210-H, T=0.15, 全区镍底 30μ MIN
触点镀金 GOLD FLASH $0.6-1.0\mu$ 焊脚双面镀亮锡 $50-80\mu$
3. 定位脚: 磷铜 C2680-H, T=0.20,
全区镍底 30μ MIN, 镀亮锡 $50-80\mu$

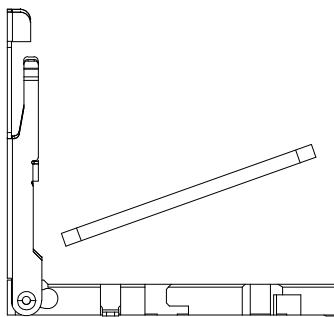
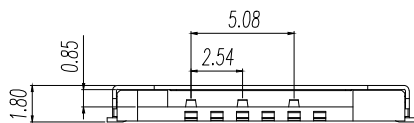
4. 外壳: 不锈钢 T=0.2

二、技术参数:

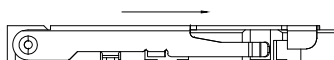
- 接触电阻: $100M\Omega$ MAX
 绝缘阻抗: $1000M\Omega$ MIN(500DC)
 额定电流: 每个接触件 1A MAX
 额定电压: 30V MAX(DC)
 耐压: 500V R.M.S/MIN
 使用温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
 湿度: 80% R.H MAX
 寿命: >3000次



MICRO SIM CARD	
Pin No.	NAME
C1	VCC OF SIM
C2	RST OF SIM
C3	CLK OF SIM
C5	GND OF SIM
C6	VPP OF SIM
C7	I/O OF SIM
C4/C8	N/A



STEP 1 INSERT MICRO SIM CARD



STEP 2 PUSH THE SHELL



STEP 3 FINISH

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA
			X ± 0.50	X $\pm 2^{\circ}$		
			.X ± 0.30	.X $\pm 1^{\circ}$	审核 CHECK	EVA
			.XX ± 0.20		批准 APPROVAL	JADE
					单位 UNITS	MM
					比例 SCALE	1:1

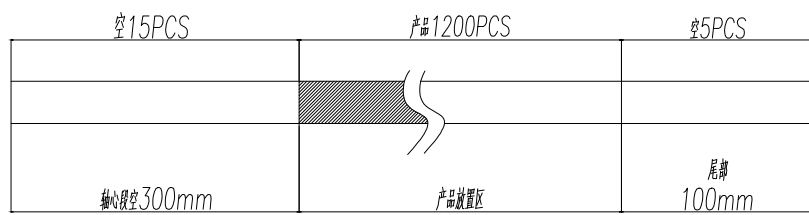
料号 PART NO.	BX-SIM-1.8HJ	版本 REV.	A
品名 TITLE	MICRO SIM CARD HINGED 6PIN H1.8	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

Bossie (博锡)

NOTES

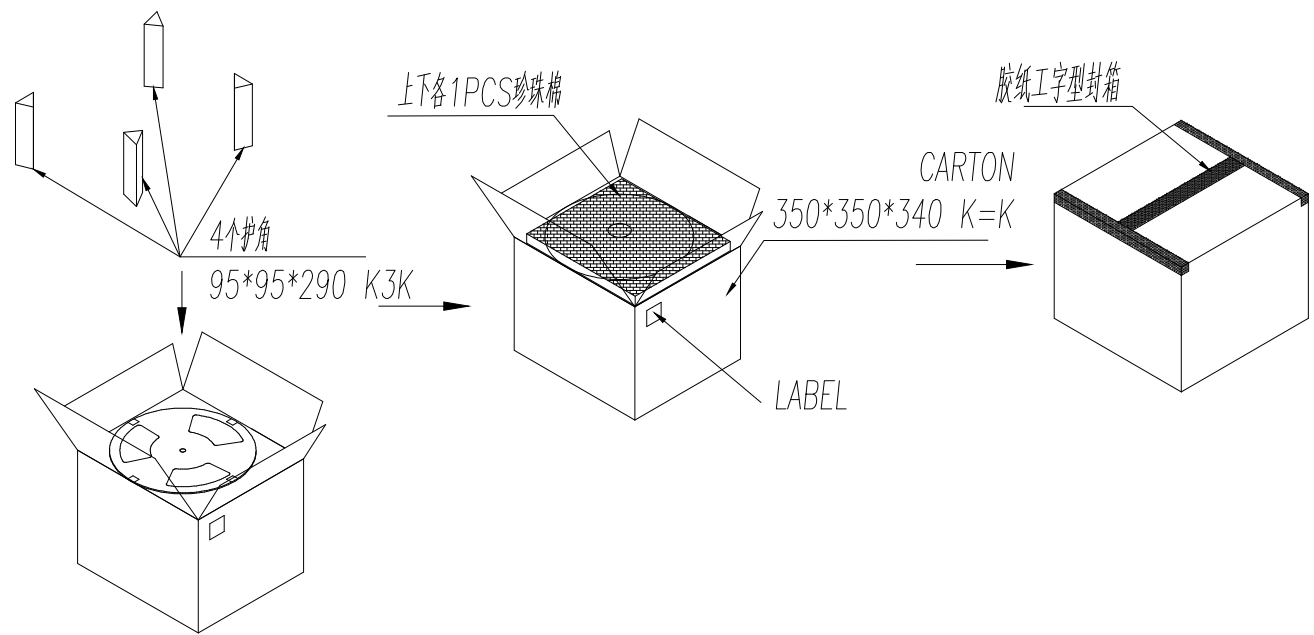
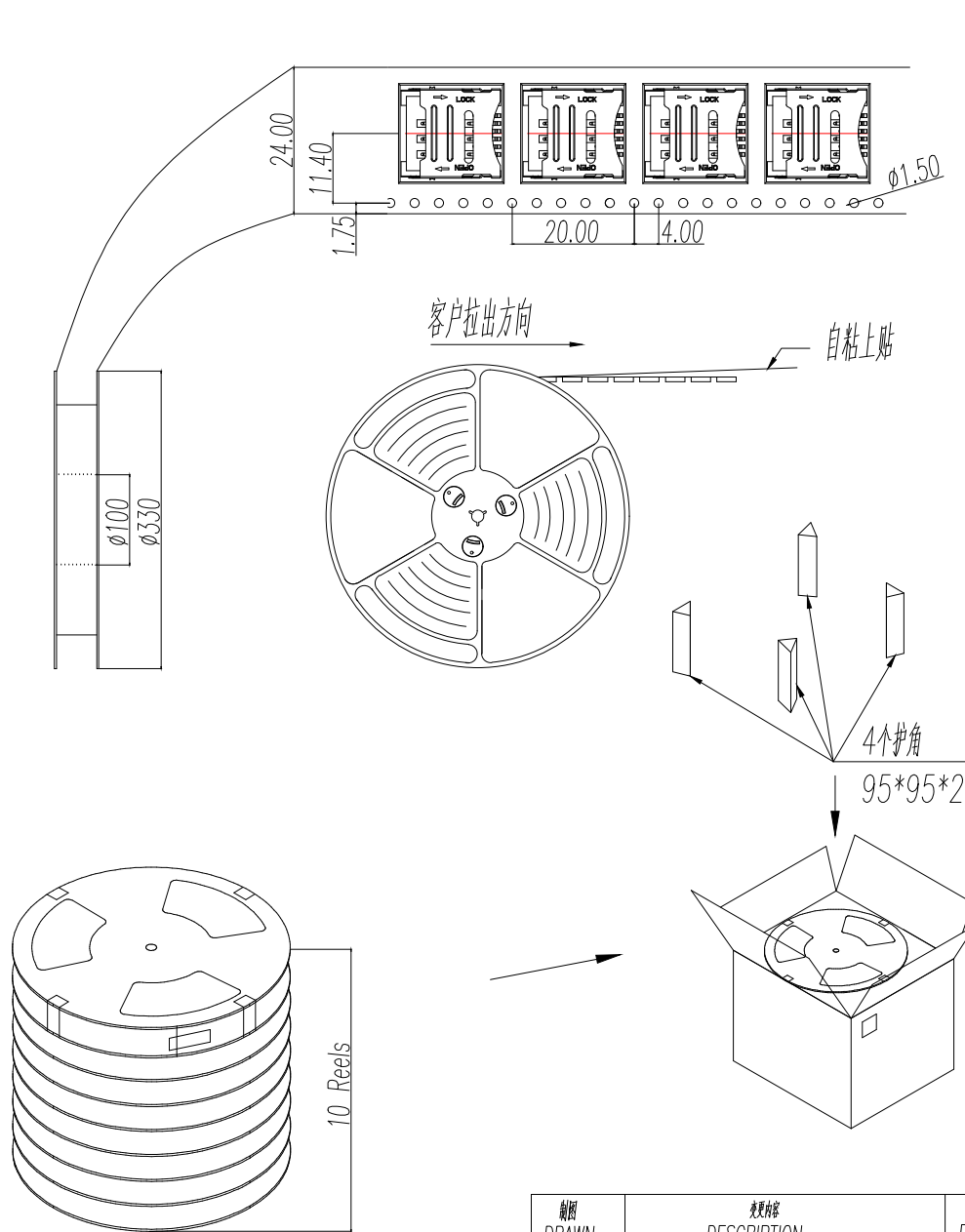
1. 每卷包装数量: 1200PCS/每卷

2. 卷带包装方式:



3. 每箱包装数量: 12000PCS/箱

4. 纸箱350mm*350mm*440mm(内部尺寸), 材质K=K



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-SIM-1.8HJ	版本 REV.	A
			X.±0.50	X'.±2"						
			.X±0.30	.X'±1"	批准 APPROVAL	JADE	品名 TITLE	MICRO SIM CARD HINGED 6PIN H1.8 贴片 封装	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.20		UNIT UNITS	MM	客户料号 CUTM.NO.			
					比例 SCALE	1:1				